

概述

HE4054H是一款输入耐压达到30V并且具有过压保护（OVP）功能，完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器，采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT与较少的外部元件数目使得HE4054H成为便携式应用的理想选择。

HE4054H可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 P MOSFET架构，加上防倒充电路，所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V，而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后，充电电流降至设定值 C/10 时HE4054H将自动终止充电。当输入电压（交流适配器或 USB 电源）被拿掉时，HE4054H自动进入一个低电流状态，电池漏电流在1μA 以下。HE4054H的其他特点包括欠压闭锁、自动再充电和一个用于显示输入电压接入和充电结束的状态引脚HE4054H具有两个充电状态开漏输出引脚。

特点

- ◆最高输入电压：30V
- ◆集成固定 6.8V 过压锁定保护功能
- ◆高达500mA可编程充电电流
- ◆精度达±1% 的4.20V，4.35V预设充电电压
- ◆无需外接MOSFET，检测电阻以及隔离二极管
- ◆恒定电流/恒定电压操作，并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
- ◆充电状态、充电终止、无电池和故障状态显示
- ◆待机模式下的静态电流为 1.0μA（典型值）
- ◆BAT端电池正负极防反接保护
- ◆2.9V涓流充电门限；C/10充电终止；自动再充电
- ◆软启动限制浪涌电流
- ◆工作温度范围-40° C至105° C

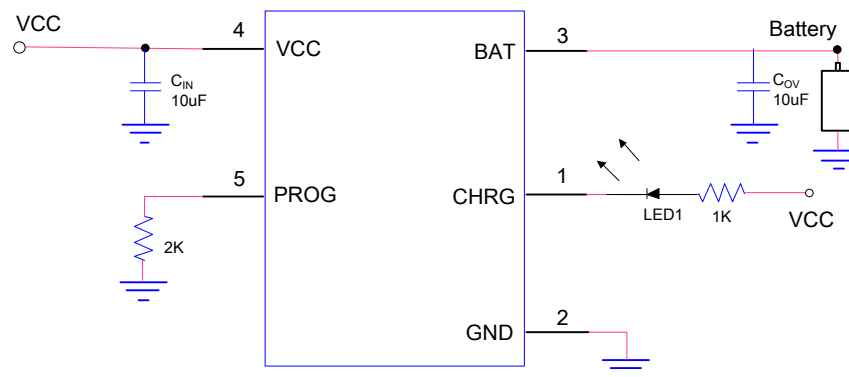
应用

- ◆ 手机、PDA、MP3
- ◆ 蓝牙应用
- ◆ 单节锂电充电设备

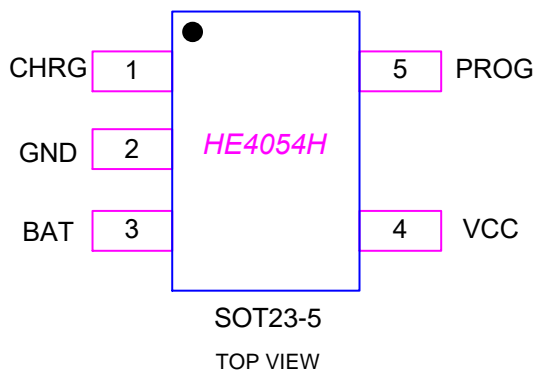
封装

HE4054H采用SOT-23-5L封装

典型应用电路



管脚描述



引脚功能

引脚	名称	功能
1	CHRG	电池充电状态指示端
2	GND	接地端
3	BAT	连接电池正极
4	VCC	电源输入端
5	PROG	可编程充电电流设置端

引脚功能描述

CHRG引脚：漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时，CHRG 管脚被内部开关拉到低电平，表示充电正在进行；否则 CHRG 管脚处于高阻态。

GND引脚：地。

BAT引脚：充电电流输出。该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电电压调节至4.2V。该引脚的一个精准内部电阻分压器设定浮充电电压，在停机模式中，该内部电阻分压器断开。

VCC引脚：正输入电源电压。该引脚向充电器供电。最大输入电压是30V，输入电压超过 6.8 V时，芯片进入停机保护模式。此处接一个4.7 μ F 或更大的X5R陶瓷去耦电容，建议将电容放置在离引脚非常近的位置。可能需要接额外的电容以稳定输入电压。当 VCC 降至 BAT 引脚电压的 50mV 以内，HE4054H 进入停机模式，从而使 IBAT降至 2 μ A 以下。

PROG引脚：充电电流设定、充电电流监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一个精度为 1%的电阻器 RPROG可以设定充电电流。当在恒定电流模式下进行充电时，引脚的电压被维持在 1V。

工作原理

HE4054H是一款专门为锂离子电池设计的线性充电器，利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒压充电。充电电流可以由外部电阻编程决定，最大充电电流可以达到500mA。HE4054H拥有两个漏极开路输出的状态指示输出端，充电状态指示端CHRG和电池充电完成指示输出端STDBY。芯片内部的功率管电路在芯片的结温超过 135 $^{\circ}$ C 时自动降低充电电流，这个功能可以使用户最大限度利用芯片充电，不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。不仅如此，HE4054H还能够从一个USB电源获得工作电源，另具有输入电源过压保护功能，从而在复杂的输入环境下保证芯片不受损坏。

■ 正常充电循环

当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上且在 PROG 引脚与地之间连接了一个精度为 1%的设定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时，一个充电循环开始。如果 BAT 引脚电平低于涓流充电门限电压 2.9V，则充电器进入涓流充电模式。在该模式中，HE4054H 提供约 10% 的设定充电电流，以便将电流电压提升至一个安全的电平，从而实现满电流充电。当 BAT 引脚电压升至涓流充电门限电压以上时，充电器进入恒定电流模式，此时向电池提供恒定的充电电流。当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压4.2V 时，HE4054H 进入恒定电压模式，且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的 C/10，充电循环结束。

■ 充电电流设定

充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。充电电流是PROG引脚输出电流的980倍，设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算：

$$R_{PROG} = \frac{980}{I_{CHG}} \quad \text{或者} \quad I_{CHG} = \frac{980}{R_{PROG}}$$

从 BAT 引脚输出的充电电流可通过监视 PROG 引脚电压随时确定，公式如下：

$$I_{BAT} = \frac{V_{PROG}}{R_{PROG}} \times 980$$

在设置充电电流大于 0.5A 应用中，芯片热量相对较大，温度保护会减小充电电流，不同环境测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用中，可根据需求选取合适大小的 R_{PROG}

R_{PROG} 选择推荐表：

R _{PROG} (KΩ)	I _{CHG} (mA)
1.8	530
2	480
3	320
5	190
10	95

■ 充电终止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的C/10，充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对PROG端进行监控来检测的。当PROG端电压降至 200mV 以下的时间超过 1.6ms 时，充电终止，HE4054H进入待机模式，此时的输入电源电流降至约100 μ A。

■ 充电状态指示

HE4054H有1个漏极开路状态指示输出端CHRG。当充电器处于充电状态时，CHRG 被拉到低电平，在其它状态，CHRG处于高阻态。当电池没有接到充电器时，CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池端连接的外接电容为1 μ F 时CHRG 闪烁周期约 0.1-0.8 秒，当电池连接端 BAT管脚的外接电容为 10 μ F 时CHRG 闪烁周期约 1-2秒。当不用状态指示功能时，将不用的状态指示输出端接到地，以下为完整的指示灯状态：

充电状态	CHRG灯
正在充电状态	亮
电池充满状态	灭
输入欠压、过压， 电池反接	灭
BAT端接电容（不接电容）， 无电池	闪烁

■ 热限制

如果芯片温度升至135℃以上时，一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止HE4054H过热，并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而减小损坏HE4054H的风险。

■ 欠压闭锁

HE4054H内部一个欠压闭锁电路对输入电压进行监控，并在 VCC 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变，则在VCC 升至比电池电压高100mV之前充电器将不会退出停机模式。。

■ 自动循环充电

电池电压达到浮充电压，充电循环被终止之后，HE4054H立即对BAT端电压进行监控。当BAT端电压低于 4.1V 时， 充电循环重新开始。确保了电池被维持在一个接近满电的状态，同时免除了进行周期性充电循环启动的需要。

■ 电池反接保护

HE4054H内置锂电池反接保护功能，当锂电池反接于芯片 BAT 引脚，芯片会停机显示故障状态，此时反接的锂电池漏电电流小于 0.1mA。将反接的电池正确接入，芯片自动开始充电循环。反接后的芯片当电池去除后，由于芯片输出端 BAT 管脚电容电位仍为负值，则充电指示灯不会立刻正常亮，只有正确接入电池可自动激活充电。或者等待 BAT 端电容负电位的电量放光，BAT 端电位大于零伏，芯片会显示正常的无电池指示灯状态。在 BAT 反接情况下，过高的电源电压在反接电池电压情形下，芯片压差会超过 10V，故在反接情况下电源电压不宜过高。

■ 充电电流软启动

HE4054H包括一个用于在充电循环开始时最大限度地减小涌入电流的软启动电路。当一个充电循环被启动时，充电电流将在 20 μ s 左右的时间里从 0 上升至满幅全标度值。在启动过程中，这能够起到最大限度地减小电源上的瞬变电流负载的作用。

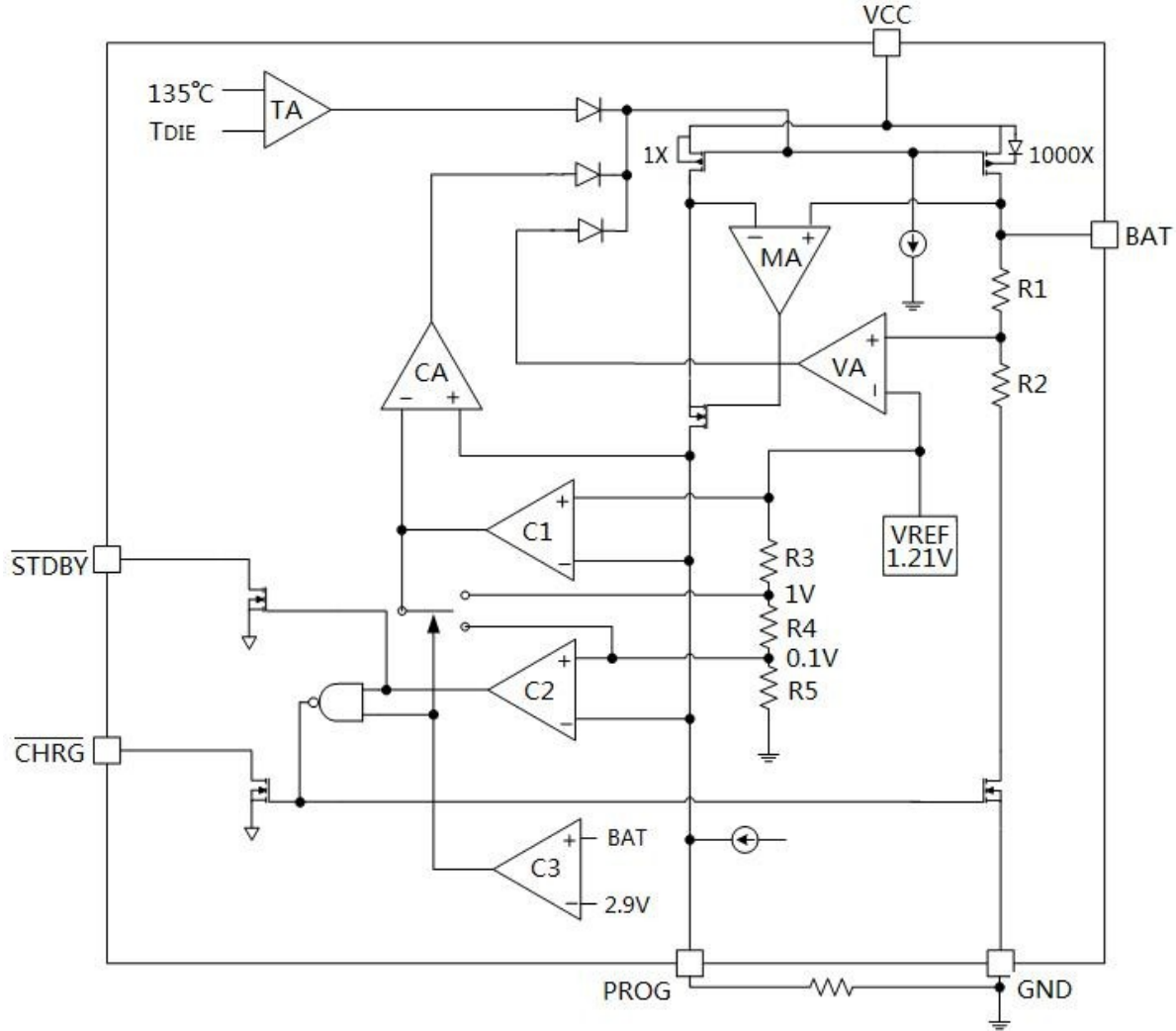
■ 输入电源电压保护 (OVP)

HE4054H具有输入电源电压 OVP 的功能，在 V_{CC} 输入电压达到 6.8V 时，芯片 OVP 保护，此时芯片停机，停止向电池充电；当电源电压再从6.8V 降低到约 6.2V 时，芯片重新进入工作状态。

■ 输入输出电容以及电阻

建议电容值：C1=10 μ F, C2=10 μ F, 同时PCB布板要求电容尽量靠近芯片。建议电阻值：R1、R2=2K，此电阻不可以省掉，以防止灯的状态故障。

结构框图



绝对最大额定值

项目	符号	范围	单位
VIN输入电压	V_{IN}	-0.3 ~ 30	V
BAT端电压	V_{BAT}	-0.3 ~ 12	V
PROG端电压	V_{PROG}	-0.3 ~ 7	V
CHRG电压	V_{CHRG} 、 V_{STDBY} 、 V_{TS}	-0.3 ~ 30	V
BAT引脚电流	I_{BAT}	700	mA
PROG引脚电流	I_{PROG}	5	mA
功率耗散 $P_D@T_A=+25^{\circ}C$	P_D	Internally limited	mW
储存温度范围	T_{STG}	-65 ~ +150	$^{\circ}C$
最大工作结温	$T_{J(MAX)}$	145	$^{\circ}C$
封装热阻	θ_{JA}	220	$^{\circ}C/W$
封装热阻	θ_{JC}	130	$^{\circ}C/W$
引脚焊锡温度(Soldering, 10sec)	T_{LEAD}	260	$^{\circ}C$
ESD静电 (Human Body Mode)		± 4000	V
ESD静电 (Machine Mode)		± 200	V

备注 1: 超过这些额定值可能会损坏器件, 不能保证设备在其工作条件之外运

行。

建议应用条件

项目	符号	范围	单位
VIN输入电压	V_{IN}	4.5 ~ 6.5	V
应用环温范围	T_{OP}	-40 ~ +85	$^{\circ}C$
充电电流	I_{BAT}	30 ~ 500	mA

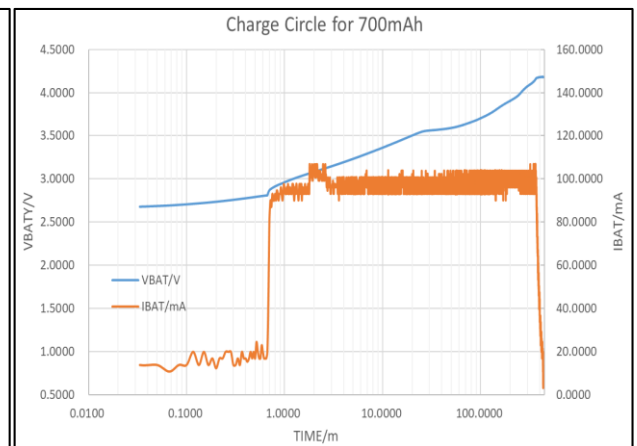
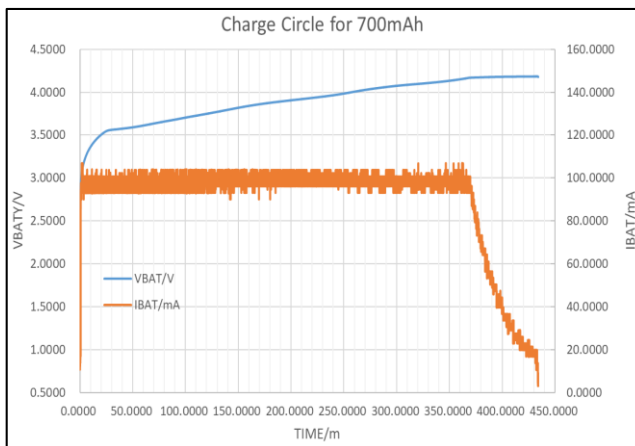
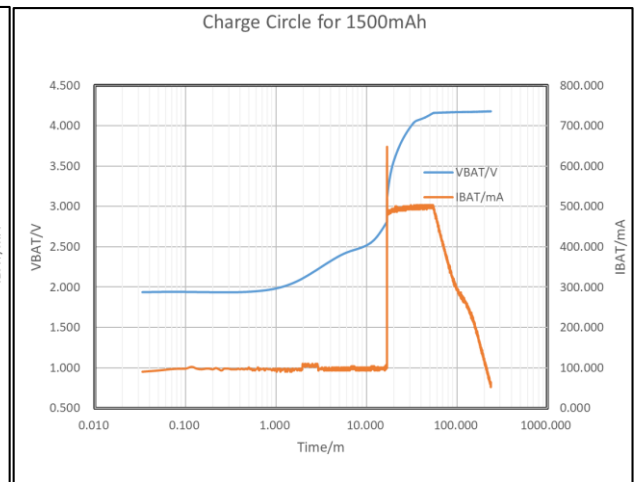
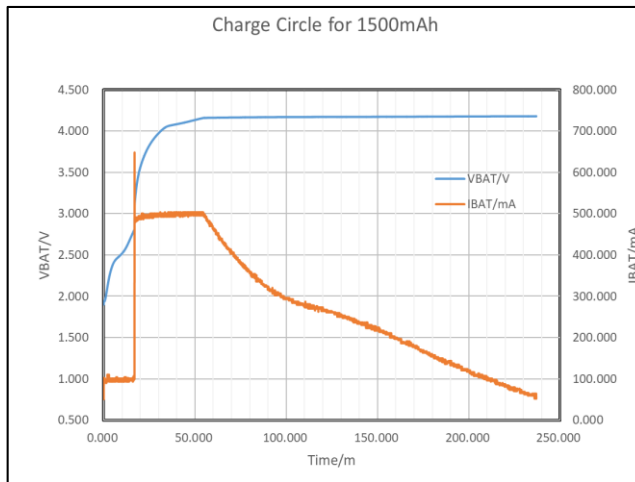
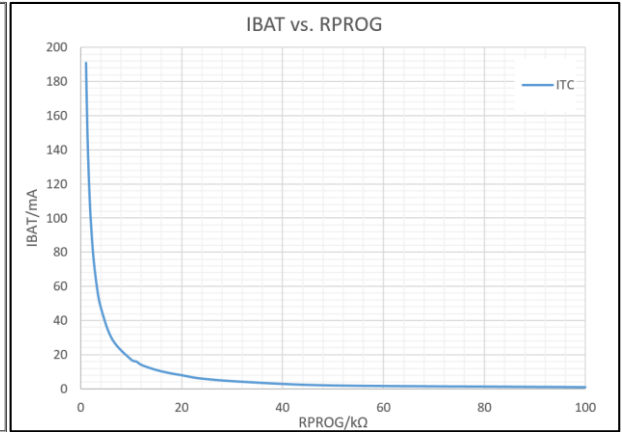
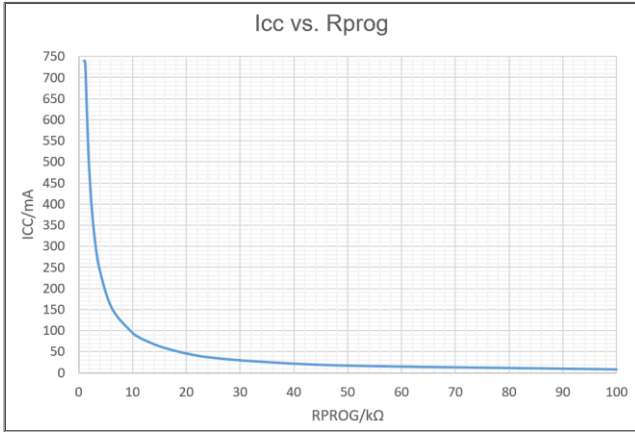
备注 2: 以上推荐工作条件均在 $T_A=25^{\circ}C$ 条件下, 除非另外特殊说明, 超出上述推荐工作条件不保证芯片正常工作。

电气特性 (如果没有特殊说明, 环境温度= 25C, 输入电压=5V)

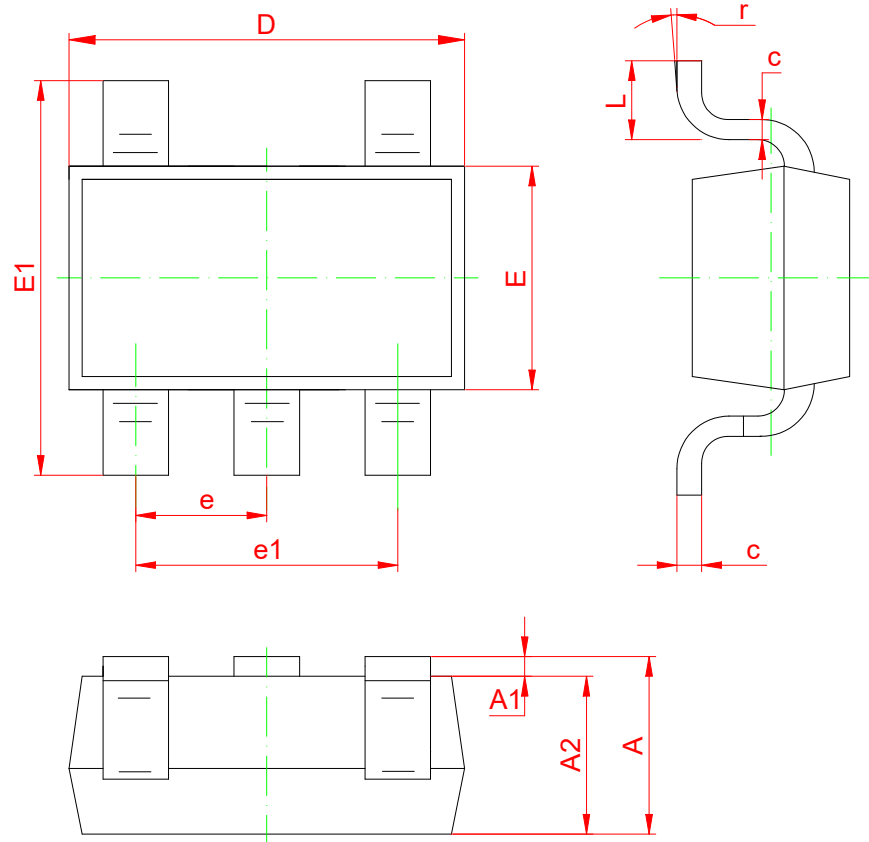
参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入电源电压	V_{IN}		4.50	5.0	6.5	V
输入过压锁定阈值电压	V_{OVLO}	V_{CC} 上升		6.8		V
输入过压锁定阈值迟滞	$V_{OVLO-HYS}$	V_{CC} 下降		450		mV
输入电源电流	I_{CC}	充电模式 ($R_{PROG}=2K$)		300	350	μA
		待机模式 (充电终止)		100		μA
		停机模式 (R_{PROG} 未连接) $V_{CC} < V_{BAT}$, or $V_{CC} < V_{UVLO}$		35	60	μA
稳定输出 (浮充) 电压	V_{FLOAT}	$0^{\circ} C \leq T_A \leq 85^{\circ} C$, $I_{BAT}=40mA$	4.16	4.20	4.25	V
BAT 端充电电流	I_{BAT}	恒流模式, $R_{PROG} = 1.6K$	550	600	650	mA
		恒流模式, $R_{PROG} = 2K$	450	500	550	mA
		待机模式, $V_{BAT} = 4.20V$		1.0		μA
		停机模式, (R_{PROG} 未连接)		1	2	μA
		电池反接模式, $V_{BAT} = -3.8V$		0.5		mA
		睡眠模式, $V_{CC} = 0 V$				0.1
涓流充电电流	I_{TRIKL}	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_{PROG}=2K$	45	50	55	mA
涓流充电门限电压	V_{TRIKL}	$R_{PROG}=2K$, V_{BAT} 上升	2.8	2.9	3.0	V
涓流充电迟滞电压	V_{TRHYS}	$R_{PROG}=2K$, V_{BAT} 下降	60	80	110	mV
VCC 欠压保护阈值电压	V_{UVLO}	V_{CC} 从低到高	3.7	3.8	3.9	V
VCC 欠压锁定迟滞电压	V_{UVHYS}	V_{CC} 下降	150	200	250	mV
手动关断阈值电压	V_{MSD}	V_{PROG} 上升	1.10	1.2	1.30	V
		V_{PROG} 下降	0.9	1.0	1.1	V
$V_{CC} - V_{BAT}$ 锁闭电压	V_{ASD}	V_{CC} 上升	70	100	140	mV
		V_{CC} 下降	5	30	50	mV
C/10 终止电流门限	I_{TERM}	$R_{PROG} = 2K$	40	50	65	mA
PROG 引脚电压	V_{PROG}	恒流模式, $R_{PROG} = 2K$	0.9	1.0	1.1	V
CHRG 端输出低电平	V_{CHRG}	$I_{CHRG}=5mA$		0.35	0.5	V
再充电电池门限电压	V_{RECHG}	$V_{FLOAT} - V_{RECHG}$	100	150	200	mV
再充电延时时间	t_{RECHG}	V_{BAT} 由高到低		1.2		ms
充电终止延时时间	t_{TERM}	I_{BAT} 降至 $I_{CHG}/10$ 以下		1.6		ms
PROG 端上拉电流	I_{PROG}			1		μA
功率 FET 导通抗阻	R_{ON}			980		m Ω
软启动时间	t_{SS}	$I_{BAT} = 0 \sim I_{BAT} = 1000 / R_{PROG}$		20		ms
限定温度模式中的结温	T_{LIM}			145		$^{\circ} C$

备注 3: 参数取决于设计、批量生产制造时通过功能性测试。

典型性能曲线



封装说明: SOT-23-5L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
r	0°	8°	0°	8°